

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



## 投资者关系活动记录表

编号：2023-008

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会）<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 招商基金 高岩；华鑫证券 王海明；中信建投证券 乔磊；国金证券 丁彦文；华安基金 谢磊、吴运阳；固禾基金 文雅；浙商证券 黄海童、黄宇宸；交银施罗德 梁简泓；太平养老保险 赵琦；永赢基金 郑奇波  |
| 时间            | 2023年9月6日  |
| 地点            | 公司会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生<br>证券事务代表 廖娅伶女士<br>证券事务专员 邵丽女士  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>Q1：公司产品应用广泛，下游行业客户众多，请问公司产品的行业壁垒在哪里呢？</b></p> <p><b>答：</b>（1）品牌壁垒。当前，国内锡膏市场主要销售份额还是由美国爱法、日本千住等知名品牌为主，他们在行业内都有几十年甚至百年的经营历史，是客户选择电子装联材料的品牌首选。公司依靠 25 年深耕行业的经验及产品品质的一致性</p>   |

及稳定性，赢得了国内外众多国内外知名客户的认可，也与众多企业建立了长数十年的合作关系，一定程度弥补和拉近了差距。

(2) 技术与工艺壁垒。微电子焊接材料行业属于技术密集型行业，涉及材料、物理、化学、机械、电子、自动控制等多个学科的交叉综合应用，而成熟的产品配方体系往往需要多年的积累，并且随着通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求微电子焊接材料更新换代速度不断加快，这对企业研发技术人员具备多种学科知识及掌握上下游行业的综合性学科知识提出了较高要求。

(3) 客户认证壁垒。作为电子材料行业的重要基础材料之一，微电子焊接材料的细微变化都可能对终端产品的导电及连接性能产生严重影响，因此下游客户对微电子焊接材料供应商的认证非常严格，知名客户的认证周期通常耗时 1 至 2 年。在通过认证后，客户通常还要通过小批量试产对供应商产品的稳定性与服务能力进行审慎评价，部分客户通过长达 1 至 2 年小批量验证后才会大批量使用。出于对产品质量稳定性、转换成本等方面的综合考虑，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此客户认证，特别是大客户认证对新进入的企业来说设置了较高的准入门槛。

**Q2：公司下游行业的构成情况大概是怎么的？**

**答：**公司下游结构与行业应用有所不同。从收入构成上来说，第一大板块为 LED 和家电；其次为通讯行业，包括基站、路由器、光猫等；再次就

是消费电子；最后是光伏、半导体和新能源板块，其中半导体业务占比较小。

**Q3：展望下半年，公司觉得下游哪些行业的发展将带动公司的发展？**

答：从上半年下游需求情况来看，传统行业 LED、家电和通讯能够保持持续增长，新兴行业光伏和新能源板块将有持续的增长。消费电子行业的增速不达预期，下半年仍有很大的不确定性。

**Q4：公司在半导体行业的进展情况如何？**

答：对于半导体行业，公司在技术研究及产品认证取得了一定的进展，但小批量试产及批量试产还需要时间周期，也需要等待客户新产品推广的速度。所以目前半导体行业类产品对公司整体业绩贡献率相对较低，短期内对业绩带动效应也不会太显著。

**Q5：公司与 H 公司的合作进展如何？**

答：公司已通过 H 公司的认证，包括供应链认证和产品认证。当前，除了汽车板块公司与 H 公司未有合作，其它板块均有覆盖。鉴于公司与客户之间签署的严格保密协议，有关客户情况及合作情况请您关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告。

接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

|         |                |
|---------|----------------|
| 附件 (如有) |                |
| 日期      | 2023 年 9 月 8 日 |